

## 征文通知

第十三届电子封装技术和高密度封装国际会议 (ICEPT-HDP2012) 将于2011年8月13日~16日在中国桂林举行。会议由中国电子学会电子制造与封装技术分会 (EMPT) 主办, 由桂林电子科技大学承办。ICEPT-HDP 系列会议多年来得到了IEEE-CPMT 的全力支持和IMAPS、ASME 和iNEMI等国际著名行业组织的积极参与, 并得到了中国电子学会、中国科协的高度评价, 已成为国际电子封装四大品牌会议之一。

电子封装技术和高密度封装国际会议为期4天, 会议将通过专题讲座、特邀报告、主题论坛、分会报告及论文张贴等形式对电子封装技术的各个领域的最新进展进行交流, 感受其无穷的魅力。

大会诚邀您的参与, 共襄盛举!

### 会议主题

- **先进封装与系统集成:** 球栅阵列封装、芯片级封装、倒装芯片; 晶圆级封装、SiP; TSV、三维集成; 及其它各种先进的封装和系统集成技术。
- **封装材料与工艺:** 绿色材料、纳米材料和其它能够提高封装性能和降低成本的新型材料; 以及各种新的封装与组装工艺。
- **封装设计与模拟:** 各种新的封装/组装设计; 电子封装的电、热、光和机械特性建模、模拟和验证方法; 多尺度和多物理量建模。
- **高密度基板及组装技术:** 嵌入式无源和有源元件基板技术; 高密度互连基板、印刷线路板、高密度高性能基板; 及其它能够提高基板密度和性能的各种新型基板技术。
- **先进制造技术与封装设备:** 先进封装技术所涉及的设备和测量方法; 提高可制造性和良品率、降低成本及改善使用可靠性的制造技术。
- **质量与可靠性:** 质量检测与评估; 加速可靠性数据采集和分析方法; 可靠性模拟和寿命预测; 失效分析和无损诊断等。
- **固态照明封装与集成:** CoB、WLP及其它各种先进的封装和集成技术; 大功率LED模组的设计、制造和测试方法; LED封装及集成技术在显示器背投、微型投影仪、室内照明和街灯等方面的应用。
- **新兴领域封装:** 传感器、执行器、微机电系统、纳机电系统、微光机电系统的封装技术; 光电子封装, CMOS图像传感器封装; 封装及集成技术在液晶显示, 无源元件, 射频、功率和高压器件, 及纳米器件等新兴领域的应用。

### 重要日期

- 论文摘要截止日期 2012年3月16日
- 论文接收通知日期 2012年4月10日
- 论文全文截止日期 2012年6月22日

### 论文/摘要投稿

论文内容必须为具有原创性且没有发表过的技术成果。论文

摘要须用约500字的篇幅清楚地描述本工作的背景、研究方法、结果和结论, 论文摘要还应包括关键的参考文献。论文摘要必须用英文、按所附电子模板的要求撰写, 发送到 [icept2012@vip.163.com](mailto:icept2012@vip.163.com)。

摘要的电子模板可从会议网站<http://www.icept.org>下载, 所有录用论文都将被收入IEEE会议论文集, 优秀论文将被推荐到IEEE-CPMT 的相关期刊评审发表。

### 优秀论文评选

会议文集将由IEEE 官方收录。会议将评选优秀会议论文和优秀学生论文, 并颁奖以示鼓励。

### 专业课程

会议将举办专业培训课程。欢迎本领域的专家通过电邮与大会组委会讨论有关课程细节, 联系邮箱为[icept2012@vip.163.com](mailto:icept2012@vip.163.com)。

### 诚信参展商/赞助商

大会将为电子封装及相关工业的材料、设备、组件、软件供应商、制造商及服务商提供参展平台, 有意向的参展商/赞助商请通过如下电子信箱与大会组委会联系: [faith\\_ape@shou.net](mailto:faith_ape@shou.net)

大会主席:	毕克允教授
大会组织主席:	潘开林教授
大会技术主席:	杨道国教授
大会网站:	<a href="http://www.icept.org">http://www.icept.org</a>
大会电邮:	<a href="mailto:icept2012@vip.163.com">icept2012@vip.163.com</a>

### 关于桂林

桂林, 位于广西壮族自治区东北部, 是世界著名的旅游胜地和历史文化名城。典型的喀斯特地形构成了别具一格的桂林山水。桂林山水以山青、水秀、洞奇、石美而享有“山水甲天下”的美誉, 其中最具有代表性的景点有: 象鼻山、漓江、七星岩、芦笛岩等。桂林至阳朔的百里漓江, 更是风光绮丽, 碧水萦回, 奇峰林立, 百态千姿……“江作青罗带, 山如碧玉簪”。“千峰环野立, 一水抱城流”、“几程漓水曲, 万点桂山尖”等古今诗人的名篇佳句, 对桂林的奇山秀水作了真实的写照和形象的描绘。



Organized by

**CIE**

CIE--Electronic Manufacturing and Packaging Technology Society



Supported by



**IEEE**



IEEE COMPONENTS, PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY SOCIETY

Co-organized by



桂林电子科技大学  
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY